微波化学气相沉积中气压对金刚石薄膜 生长速率和质量的影响*

李晓红^{1 2}⁾ 郭晚土² 陈学康² 吴 敢² 杨建平² 王 瑞² 曹生珠² 余 荣²

1 () 西南科技大学理学院,绵阳 621010) 2 () 兰州物理研究所,兰州 730000)

(2006年12月14日收到;2007年5月14日收到修改稿)

研究了微波化学气相沉积中沉积气压对金刚石薄膜生长速率和质量的影响,研究表明,金刚石薄膜的生长速率随沉积气压的提高而增大,生长速率与沉积气压为线性关系,在高沉积气压下生长的金刚石薄膜晶形完整,拉曼 谱测量可得到锐利的金刚石相的峰,但电压-电流测量表明,随着制备时沉积气压的提高,金刚石薄膜的暗电流增 大,膜的电学质量下降.

关键词:金刚石薄膜,生长速率,沉积气压 PACC:6855,7520C

1.引 言

尽管自 20 世纪 80 年代以来金刚石薄膜已经得 到了大量的研究^{1→4〕},但是目前金刚石薄膜的生长 速率仍然不高(生长速率通常为每小时若干微米). 在很多应用中要求金刚石薄膜的厚度在几百微米, 这意味着需要沉积近百小时或更长时间,从而大大 增加了金刚石薄膜的成本,限制了金刚石薄膜的应 用.如何提高金刚石薄膜的生长速率一直是金刚石 薄膜研究的一个重要方向.金刚石薄膜的沉积条件 一般是沉积气压为 10³—10⁴ Pa,基片温度为 800— 900 ℃.新的研究表明^[56],对于微波等离子体化学 气相沉积(MPCVD)法,在高气压(高于 10⁴ Pa)和高 基片温度(约1200 ℃)下,金刚石薄膜的生长速率可 得到很大提高.本文利用 MPCVD,研究了较低的基 板温度下高的沉积气压对金刚石薄膜生长速率和质 量的影响.

2. 实验方法

本实验采用从俄罗斯进口的 DF100 型 MPCVD 系统,该系统采用频率为 2.45 GHz 的微波源,其最 大输出功率为 6 kW,并且可在 0.6—6 kW 连续可调. 沉积中采用甲烷和氢气作为反应气体.基片为直径 3 cm 的单晶硅片.沉积的主要参数如表 1 所列.

表1 金刚石薄膜的沉积条件

微波功率/kW	基板温度/℃	氢气流量/cm ³ ·min ⁻¹	甲烷流量/cm ³ ·min ⁻¹	压力/10 ⁴ Pa	沉积时间/h	薄膜厚度/μm
4.0	~ 900	800	~ 8	1.0-1.7	5	20—100

本实验主要通过 Raman 谱分析金刚石薄膜的 相成分, Raman 谱仪的入射波长为 532 nm. 金刚石薄 膜结构的分析主要利用扫描电子显微镜(SEM)和 X 射线衍射(XRD),其中 XRD 测量中所用 X 射线为 Cu的 Kα线,波长为 0.154 nm. 金刚石薄膜在经过表 面清洗后 利用激光脉冲沉积系统和微刻蚀系统制 备了叉指电极,利用 ASEC-03 型电学性能测量系统 测量了电压-电流曲线.

^{*} 西南科技大学博士研究基金(批准号 106ZX7113)资助的课题.

[†] E-mail :lixiaohong@swust.edu.cn

3. 实验结果

图 1 给出了沉积气压对金刚石薄膜生长速率的 影响.从图 1 可以看出,在其他沉积条件保持不变的 情况下,金刚石薄膜的生长速率随着沉积气压的升 高呈线性增加.1.68 × 10⁴ Pa 时的生长速率约为 1.03 × 10⁴ Pa 时的 5 倍.

图 2、图 3 和图 4 分别给出了样品的 Raman 谱、 SEM 照片和 XRD 谱,沉积气压分别为 1.03 × 10⁴ 和 1.68 × 10⁴ Pa. 不同气压下沉积的金刚石薄膜的 Raman 谱差别不大,除了金刚石相的 1332 cm⁻¹峰 外,没有出现其他相成分的峰,膜越厚,1332 cm⁻¹峰 越锐利.XRD 测试中,只出现了金刚石的峰.低沉积 气压下生长的金刚石薄膜,出现了金刚石的(111)和 (220)峰.高气压下生长的金刚石薄膜,可以看到多 个峰,除(111)和(220)外,还有(311)(400)和(331) 峰.从出现的峰和峰的强度分析,低气压下生长的金



刚石薄膜以[111]取向为主,高气压下则有一定的 [100]取向,这和SEM的测试结果一致.

图 5 给出的是金刚石薄膜的电压-电流曲线.电压-电流测试表明,膜的沉积气压提高时,暗电流 上升.



图 1 金刚石薄膜的生长速率随气压的变化关系 圆点为 实验点,实线为拟合曲线



图 2 样品的 Raman 谱 (a) 沉积气压为 1.03 × 10⁴ Pa (b) 沉积气压为 1.68 × 10⁴ Pa







图 4 样品的 XRD 谱 (a)沉积气压为 1.03 × 10⁴ Pa (b)沉积气 压为 1.68 × 10⁴ Pa

4. 分析和讨论

文献 6 指出,在基片温度为1150 ℃、甲烷流量 占气体总流量的 5%时,金刚石薄膜的生长速率随 气压提高(6.58×10³—1.64×10⁴ Pa)而增大,呈现线 性关系.这和我们在较低基板温度(约900 ℃)和较 低甲烷流量(占总流量的 1%)得到的结果类似,但 我们得到的生长速率要高一些.文献 5 6 J从 Raman 谱推断金刚石薄膜的质量随沉积气压的增加而提 高.我们的 Raman 谱测量表明,金刚石薄膜的 Raman 谱 1332 cm⁻¹峰随着沉积气压的提高而更加锐利.我 们认为,在可以沉积金刚石薄膜的气压区间内(金刚 石薄膜的生长对沉积气压有一定的要求),金刚石薄 膜的 Raman 谱的这种变化主要归结于金刚石薄膜 厚度的变化,而不是金刚石薄膜质量的提高.对金刚 石薄膜电压-电流曲线的测量结果清楚地表明,高气 压下沉积的金刚石薄膜的暗电流要明显高于通常气



图 5 样品的电压-电流曲线 (a)沉积气压为 1.03 × 10⁴ Pa, (b)沉积气压为 1.68 × 10⁴ Pa

压下沉积的金刚石薄膜.

金刚石薄膜的生长速率 G 和质量(用薄膜的缺陷密度 X_{def} 表示)由等离子体内和金刚石薄膜表面 一系列的反应决定,生长速率最终依赖于基片表面 的原子氢和甲基的浓度(分别用[H]_{ur}和[CH₃]_{ur}表 示)⁷¹. G 与[CH₃]_{ur} [H]_{ur}的关系可近似地表示 如下:

$$G \propto \frac{\left[\begin{array}{c} CH_3 \\ 1 \\ \alpha \end{array} + \left[\begin{array}{c} H \\ 1 \\ \end{array} \right]_{ur}}{\alpha + \left[\begin{array}{c} H \\ 1 \\ \end{array} \right]_{ur}}, \qquad (1)$$

式中 a 为常数 $,a = 3 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$.

 X_{def} 与 G 和 H] "的关系可表示为

$$X_{\rm def} \propto \frac{G}{[H]_{\rm ur}^2}$$
 (2)

文献 8 对通常的沉积条件计算的结果表明,一般情况下[H]_w通常要比 *a* 至少小一个数量级,因而可将(1)(2)式写成

$$G \propto [CH_3]_{sur} [H]_{sur}$$
, (3)

$$X_{\rm def} \propto \frac{\left[\begin{array}{c} \mathrm{CH}_3 \end{array} \right]_{\mathrm{ur}}}{\left[\begin{array}{c} \mathrm{H} \end{array} \right]_{\mathrm{ur}}}.$$
 (4)

从(3)(4)式可知,G与[CH3]_m和H]_m成正比,而

X_{def}则与[CH₃]_u,成正比,与[H]_u,成反比.从实验结 果看,气压的升高很可能增加了[CH₃]_u,从而增加 了金刚石薄膜的生长率、降低了膜的质量.更准确的 分析还有待于对金刚石薄膜沉积时等离子体内成分 的分析而定.

5.结 论

在较低基板温度下,金刚石薄膜的生长速率随

沉积气压的提高而增大,生长速率与沉积气压为线 性关系.在高的沉积气压下生长的金刚石薄膜,从 SEM 照片可看到晶形完整,Raman 谱测量可得到锐 利的金刚石相的峰,这与高基板温度下的结果一致. 但电压-电流曲线测量表明,随着制备时沉积气压的 提高,金刚石薄膜的暗电流增大,膜的电学质量下 降.这可能是气压的提高使得基片表面甲基浓度增 大,从而提高了金刚石薄膜的生长速率、降低了膜的 质量.

- [1] Liu C Y, Liu C 2003 Acta Phys. Sin. 52 1479 (in Chinese] 刘存 业、刘 畅 2003 物理学报 52 1479]
- [2] Su Q F, Liu J M, Wang L J, Shi W M, Xia Y B 2006 Acta Phys. Sin. 55 5145 (in Chinese)[苏青峰、刘健敏、王林军、史伟民、 夏义本 2006 物理学报 55 5145]
- [3] Ma B X, Yao N, Jia Y, Yang S E, Lu Z L, Fan Z Q, Zhang B L
 2005 Acta Phys. Sin. 54 2853 (in Chinese)[马丙现、姚 宁、
 贾 瑜、杨仕娥、鲁占灵、樊志琴、张兵临 2005 物理学报 54
 2853]
- [4] Zhou Z Y , Chen G C , Tang W Z , Lü F X 2006 Chin . Phys. 15

980

- [5] Sternschulte H, Bauer T, Schreck M, Stritzker B 2006 Diam. Relat. Mater. 15 542
- [6] Li X L, Perkins J, Collazo R, Nemanich R J, Sitar Z 2006 Diam. Relat. Mater. 15 1784
- [7] Mortet V, Kromka A, Kravets R, Rosa J, Vorlicek V, Zemek J, Vanecek M 2004 Diam. Relat. Mater. 13 604
- [8] Gorbachev A M ,Koldanov V A , Vikharev A L 2001 Diam. Relat. Mater. 10 342

Li Xiao-Hong^{1,2,)†} Guo Wan-Tu²) Chen Xue-Kang²) Wu Gan²) Yang Jian-Ping²)

Wang Rui²) Cao Sheng-Zhu²) Yu Rong²)

1 X School of Science, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621010, China)
 2 X Lanzhou Institute of Physics, Lanzhou 730000, China)

(Received 14 December 2006; revised manuscript received 14 May 2007)

Abstract

The effect of total pressure on growth rate and quality of diamond films prepared by microwave plasma chemical vapor deposition was investigated. The results show that when the total pressure changed from 1.03×10^4 to 1.68×10^4 Pa the growth rate increased from 3 to 16 μ m/h. For the diamond films prepared at high deposition pressure , scanning electron microscope images show clearly the crystals and the Raman spectra have sharp peaks at 1332 cm⁻¹ , which shows good quality of diamond films. However , the voltage-current relation shows the electrical quality of diamond films decreased since the defect density of surface may increase at high deposition pressures.

Keywords : diamond films , growth rate , deposition pressure PACC : 6855 ,7520C

^{*} Project supported by the Doctoral Research Foundation of Southwest University of Science and Technology, China (Grant No. 06ZX7113).

[†] E-mail :lixiaohong@swust.edu.cn